

晶圆助焊剂WS-3543

简介

晶圆助焊剂WS-3543是一款低黏度的半导体级助焊剂，专门为了在直径不超过300mm（12英寸）的晶圆生成统一、无氧化的焊点而优化配方。焊点形成过程中不存在缺锡的情况。即使是多次应用/回流/清洗循环后，**WS-3543**仍然很容易被清洗掉，无残留。

特点

- 溶于水
- 黏度适用于150-300mm的晶圆
- 无残留
- 无卤素 - 无添加卤素
- 帮助形成一致的焊点
- 适用于SnPb和无铅焊接制程

属性

属性		测试方法
助焊剂类型	ORM0	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 & 2.3.33)
颜色	琥珀色到黄色	肉眼观察
典型黏度	91cst	Cannon-Fenske黏度计
典型酸值	56 mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻 SIR (ohms)	合格 (>10 ⁸ : 7 天后, 85°C, 相对湿度85%)	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
比重	0.988g/cc	J-STD-004B
保质期	6个月	0 - 25°C

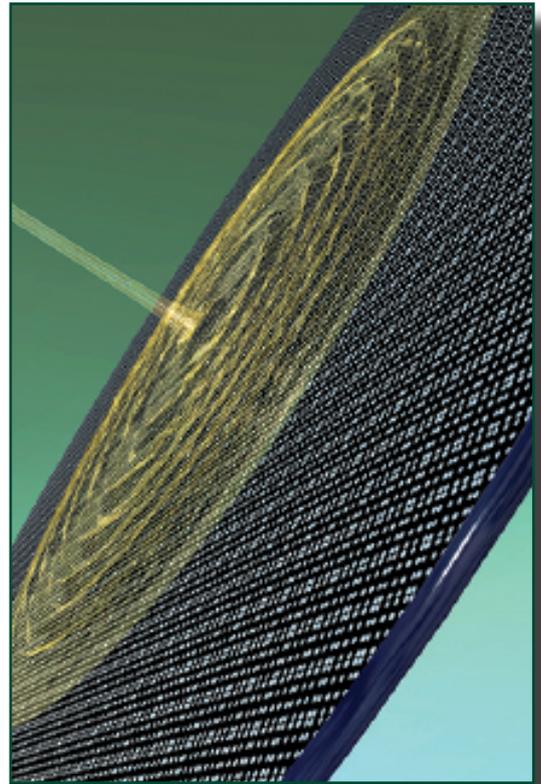
所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

应用

WS-3543可用标准的喷涂或者旋涂技术涂覆。

旋涂：采取初始转速来保证液态助焊剂被均匀地涂布在晶圆上，然后根据具体应用采用15rpm到800rpm的转速。晶圆的尺寸、局部结构、间距和助焊剂应用都是能影响转速的变量。快速旋转被用于减小助焊剂的厚度和去除晶圆上过多的助焊剂。

喷涂：助焊剂储存罐中的助焊剂应足够持续供应8小时。罐内剩余的助焊剂如果存放时间过长可能会过期（室温下可在罐内存放8小时以上）。喷雾器需要经常清洗，从而有效地保证此助焊剂或其他助焊剂的纯净度。



安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。

翻页 →

晶圆助焊剂WS-3543

包装

WS-3543按重量出售 (g)。包装规格通常为100克到3.7千克 (约1加仑)。其它特殊包装可应求提供。

清洗

WS-3543可用去离子水 (DI) 和添加了清洗剂的水溶液清洗。喷雾清洗的理想条件为: 25°C (或更高) 温度下, 用超过60psi的压力冲洗超过1分钟。



技术服务

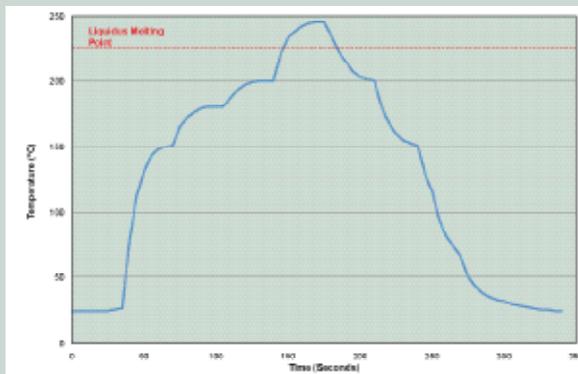
钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面, 其快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务, 将第一时间回应所有技术咨询。

储存

为了保证达到其最长的保质期, WS-3543应储存在0-25°C的环境中。不能在超过25°C的环境中储存超过4天, 温度也绝对不能超过30°C。应至少提前4小时从冷藏环境中取出, 使其能在使用前达到室温。

回流

推荐的温度曲线



我们推荐使用上面的曲线作为300mm晶圆 (SnAg微型凸点) 的初始参考。然而针对不同应用, 应对此曲线进行优化来满足特定需求。晶圆应在氮气气氛中回流。氧气最好低于10ppm, 但是低于20ppm也可行 (但结果可能不够好)。请注意, 桥连或缺锡的现象可能出现在铜柱的细间距微型凸点 (<60微米) 上, 而降低峰值温度可以减少此类故障的产生。

本产品说明书仅供参考, 并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明, 钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络: china@indium.com

更多详情: www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900

